证券代码：300236　　证券简称：上海新阳

上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参见附件：参会投资者名单
时间	2026年11月25日 14:30-16:00
地点	上海新阳公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理、总工程师王溯、财务总监周红晓、董事会秘书杨靖、证券事务代表张培培
投资者关系活动主要内容介绍	**1. 公司经营情况简介：** 公司主要有两大类业务，一类为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务，并为客户提供整体化解决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务业务，并为客户提供专业的整体涂装业务解决方案。 公司自1999年成立以来，始终坚持以技术为主导的发展战略，始终坚持自主研发，持续创新；始终坚持面向产业需求，面向前沿技术，面向国内空白，面向进口替代的战略定位。目前公司产品已覆盖电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨、电子蚀刻五大系列。 2026年1-9月，公司实现营业收入18.54亿元，较去年同期增长33.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，同比增长57.42%，扣除非经常性损益后净利润为3.21亿元，同比增长62.69%。公司半导体行业实现营业收入15.67亿元，同比增长44.12%，其中先进制程用关键工艺材料产品占半导体业务营收超80%。得益于长期积累的技术及产品迭代研发能力，公司集成电路制造用关键工艺材料产品规模不断扩大，新品市场拓展进展良好，下游客户订单保持增长态势。涂料板块业务，截至2026年三季度末实现营业收入2.86亿元，同比略有下降，受行业景气度及内卷困局影响，净利润同比小幅

	下滑。 **2.公司电镀液及清洗液产品被列为Baseline的情况？** 答：公司自主开发的用于芯片铜互连的电镀系列产品（包括大马士革铜互连、TSV、Bumping等工艺材料），及晶圆制造干法刻蚀后铜/铝制程清洗材料，成为Baseline的数量逐年增加。截至2025年末，国内投产运营的产线里，已有66条12寸产线、25条8寸产线将公司产品列为Baseline基准材料，对应占比分别超80%、50%。 **3.公司光刻胶业务的最新进展及未来产能规划情况？** 答：公司长期致力于推动高端光刻胶及配套产品国产化率的提升，公司光刻胶产品覆盖I线、KrF、ArF干法、ArF浸没式各类高端光刻胶，目前已经全面承接国内主流晶圆制造企业国产替代项目，产品已进入产业化导入阶段，稳定供货的光刻胶项目量快速增加，产品规模不断扩大。公司光刻胶项目进展基本符合预期，未来公司光刻胶产品的生产主要在松江本部和上海化学工业区。 **4.公司蚀刻液产品主要有哪些类别？** 答：公司晶圆制造用蚀刻液系列产品为面向存储芯片制造领域开发的电子蚀刻系列产品。公司已开发面向存储器芯片制造的全品类蚀刻液材料。 **5.公司研磨液产品覆盖的品类及最新进展情况？** 答：公司化学机械研磨液产品覆盖14nm及以上技术节点，包括STI slurry、Poly slurry、W slurry、Oxide slurry等，各系列产品在头部客户端测试验证顺利，并进入国内主流晶圆公司产线，高技术节点研磨液产品应用逐步增加，销售额较上年同期快速增长。 **6.公司现有产能情况及未来产能规划？** 答：公司目前松江本部有1.9万吨/年产能；合肥新阳规划扩充至4.35万吨/年，预计年底建成，部分电镀液、蚀刻液、清洗液扩产产线及研磨液产线均已顺利投产；松江本部128亩新建项目规划设计产能5万吨/年，厂房、仓库已结构性封顶，目前进展顺利，预计明年下半年投产；上海化学工业区规划设计产能3.05万吨/年，已于2026年9月开工建设，2028年6月竣工，2028年年底投产。 **7.公司研发投入强度、研发资金投向情况？** 答：公司始终秉持自主创新的开发理念，高度重视研发与创新，已成功研发出拥有自主知识产权的集成电路关键工艺材料五大核心技术产品。公司半导体板块上市以来研发投入年均占营收比近20%，基本保持平稳。公司研发投入主要集中于集成电路制造用光刻胶、先进制程蚀刻液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等项目开发。

	8.公司蚀刻液产能布局高的原因？ 答：随着AI算力、云存储等新兴领域的快速发展，更高密度存储芯片的需求不断增长，高性能蚀刻液需求也将相应增加。公司开发的电子蚀刻系列材料是存储器芯片生产制造过程中的关键工艺材料，在芯片技术升级迭代中起关键作用。公司作为该材料领域的关键供应商，应配合下游客户共同完成技术迭代，提前做好产能布局，应对市场需求。 **9.公司半导体业务毛利率的情况？** 答：公司半导体业务产品毛利率会有一定范围内的波动，主要受公司产品结构、原材料成本、新扩建项目等因素影响。今年公司受部分原材料价格持续上涨影响，三季度毛利率略有下降。公司会结合原材料涨价情况、行业市场情况、产品结构情况等因素综合定价，并不断提升规模化运营效率，积极推动新产品导入放量，保持公司半导体业务毛利率水平稳定。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	参会投资者名单
日期	2026年11月25日

附件：参会投资者名单

序号	公司
1	安联基金管理有限公司
2	贝诺资本
3	碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司
4	淳厚基金管理有限公司
5	东北证券股份有限公司
6	东方财富证券股份有限公司
7	工银安盛资产管理有限公司
8	国海富兰克林基金管理有限公司
9	国海证券股份有限公司
10	国联民生证券股份有限公司
11	杭州附加值投资管理有限公司
12	华宝证券股份有限公司
13	华能贵诚信托有限公司
14	泉果基金管理有限公司
15	山西证券股份有限公司
16	上海国科龙晖私募基金管理有限公司
17	上海和谐汇一资产管理有限公司
18	上海汇正财经顾问有限公司
19	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
20	上海理臻投资管理有限公司
21	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
22	上海万纳资产管理有限公司
23	上海运舟私募基金管理有限公司
24	申万宏源证券资产管理有限公司
25	西部证券股份有限公司
26	兴业证券股份有限公司
27	银河基金管理有限公司
28	长江养老保险股份有限公司
29	长盛基金管理有限公司
30	浙江浙商证券资产管理有限公司
31	浙商证券股份有限公司
32	中科企创(北京)信息技术研究院
33	中欧基金管理有限公司
34	中信建投证券股份有限公司

35	中信证券股份有限公司
36	中银国际证券股份有限公司
37	中银基金管理有限公司